

杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	巨创基金
时间	2026年5月13日
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：纪臻
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请介绍一下公司 2025 年度及 2026 年一季度的业绩情况。</p> <p>答：2025 年，公司在持续深耕并拓展医疗健康及工业仪表芯片领域的基础上，通过整合与研发，业务延伸至智能家电及电池管理（BMS）芯片领域，产品矩阵进一步丰富。报告期内，公司实现营业收入 17,358.47 万元，同比增长 28.73%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,213.89 万元，同比增亏 310.31%。公司净利润亏损增加，主要系：1）公司围绕长期竞争能力提升，持续强化研发、丰富产品矩阵、市场拓展及人才引进等方面的资源保障，公司经营费用同比增加；2）并购整合产生的非经常性损益以及计提商誉减值等事项，对当期利润造成影响。报告期内，公司主营业务毛利率为 51.29%，同比减少 7.85 个百分点，主要</p>

系新增晶华智芯并表影响。

一季度为消费电子传统淡季，但随着前期推出新产品（带 HCT 功能的血糖仪专用芯片、新一代信号调理及变送输出芯片等）的持续推广、客户导入并实现规模出货，同时公司加大市场拓展力度，2026 年一季度，公司实现营业收入 4,609.90 万元，同比增长 24.46%。主营业务中，医疗健康芯片产品收入占比为 37.36%，工业仪表芯片产品收入占比为 38.83%，智能感知芯片产品收入占比为 22.52%，电池管理芯片产品收入占比 1.29%。公司主营业务毛利率 50.57%，其中晶华微主营业务毛利率 56.22%，子公司晶华智芯主营业务毛利率 30.08%。

Q2：公司目前有哪些产品线布局？

答：公司始终专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，深耕带有高精度 ADC 的信号处理 SoC 芯片技术，面向医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理等下游终端应用市场，整合算法及应用解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。此外，为更好满足现有客户需求并与现有产品线形成配套（如医疗健康领域的动态血糖监测 CGM、电池管理领域的两轮车应用等），实现“AFE+MCU+无线传输+数据分析+应用方案”的全链条服务能力，公司于 2025 年新设了物联网无线传输产品线。物联网无线传输市场空间广阔，该布局也将助力公司拓展增量市场。

Q3：请介绍公司 2025 年度的研发投入情况。

答：报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发费用 9,705.66 万元，同比增长 33.00%，占营业收入比重为 55.91%。截至报告期末，公司研发人员 138 名，占员工总数 61.06%。2025 年度，公司新立项芯片研发项目 18 个，同比增长 125.00%，公司在研芯片项目数量同比增长 36.96%，流

	<p>片次数同比提升 112.50%，研发活动保持高活跃度。</p> <p>报告期内，公司在各产品领域研发取得积极进展：医疗健康领域，重点推进 3V 双通路动态血糖仪模拟前端芯片项目，目前样片测试良好，正在进行样机开发与应用验证；此外，带 20bitADC 和 LCD 驱动的高性价比新工艺 SoC 芯片项目、4/8 电极 BIAAFE 芯片项目已完成流片，进入测试验证阶段。工控仪表领域，中高端万用表 SoC 芯片已完成初步样片测试，正在制作 demo 样机进行整机验证。智能感知领域，全功能 32 位智能家电 MCU 控制器芯片、72XX 系列高性价比增强型 8 位 MCU 控制器芯片已完成研发设计，进入推广销售阶段；带有 I/O 全映射和 8051 核的高性价比 MCU 芯片已完成研发设计及方案开发，获得客户认可，该芯片可与公司 BMS AFE 芯片配套，为客户提供一站式解决方案。电池管理领域，18-26 串锂/钠电池监控和保护芯片正在进行优化迭代；集成二级电压保护的 3-7 串锂电池 AFE 芯片项目已完成样片测试，正在推广试用中。</p> <p>Q4：请问公司研发人员占比多少？</p> <p>答：公司秉承“人才优于愿景、客户至上、极致可靠、创新前瞻”的价值理念，坚持积极进取的人才培养方式和人才选拔任用程序，2025 年度公司研发人员占比为 61.06%，拥有专业的 IC 设计研发能力及国际化视野，在创新产品的研发上形成了显著优势。</p> <p>Q5：请介绍公司今年的业务进展情况。</p> <p>答：2026 年一季度，公司研发项目进展顺利，比如专用于动态血糖监测的 3V 双通路模拟前端芯片项目已完成样片测试，性能良好，目前正在进行样机开发与应用验证；专用于电机驱动的带有 I/O 全映射和 8051 核的高性价比 MCU 芯片项目，电动工具方案已完成开发，并获得客户认可，该芯片也可与公司 BMS AFE 芯片配套，为客户提供一站式解</p>
--	--

	决方案。市场销售方面，公司新一代信号调理及变送输出芯片在压力传感器、温度传感器、液位传感器等应用的基础上，已成功导入机械臂、机器人力传感器应用；晶华智芯的 78 系列高性能触控显示智能控制芯片已在重点客户中陆续验证导入，72JE 系列高性价比小家电触控芯片已实现批量出货，并正积极推进导入终端品牌客户。
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 13 日